

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-013

深南电路股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
传真	0755-86096378	0755-86096378	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

深南电路成立于 1984 年，始终专注于电子互联领域，经过四十余年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB 供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据 PrismaMark 2025 年第四季度报告，预计 2025 年公司营收规模在全球印制电路板厂商中位列第 4。

1) 印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据 PrismaMark 2025 年第四季度报告统计，2025 年以美元计价的全球 PCB 产业产值 852 亿美元，同比增长 15.8%，其中 18 层及以上多层板、HDI 增速明显高于行业水平，主要得益于数据中心、高速网络通信等 AI 算力基础设施硬件相关产品需求保持较高增长。从中长期看，PCB 产业将延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势，18 层及以上的高多层板、HDI 板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平，分别为 21.7%、9.2%、10.9%。从区域分布看，未来五年全球各区域 PCB 产业仍呈增长态势，其中，中国大陆地区复合增长率为 7.0%。

2025-2030 年 PCB 产业发展情况预测（按产品）

单位：百万美元

类型/年份	2024	2025E		2030F	2025-2030F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
纸基板/单面/双面板	7,947	8,440	6.2%	9,709	2.8%
4-6 层板	15,586	16,556	6.2%	19,493	3.3%
8-16 层板	9,555	11,665	22.1%	15,985	6.5%
18 层板及以上	2,853	4,928	72.8%	13,159	21.7%
HDI	12,518	15,769	26.0%	24,490	9.2%
封装基板	12,602	14,891	18.2%	24,986	10.9%
柔性板	12,504	12,903	3.2%	15,527	3.8%
合计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

数据来源：PrismaMark 2025 Q4 报告

2025-2030 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2024	2025E		2030F	2025-2030F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
美洲	3,533	3,796	7.5%	4,781	4.7%
欧洲	1,638	1,864	13.8%	2,307	4.4%
日本	5,840	6,499	11.3%	9,468	7.8%
中国大陆	41,073	48,969	19.2%	68,535	7.0%
亚洲（日本、中国大陆除外）	21,482	24,024	11.8%	38,257	9.8%
合计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

数据来源：PrismaMark 2025 Q4 报告

2) 电子装联行业发展状况

电子装联处于 EMS 行业，指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS 厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外的服务能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括 PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力已成为电子装

联行业的核心竞争力之一。此外，EMS 行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深化，客户需求更加多样化、个性化，且新技术新产品迭代和更新频率加快，对于 EMS 厂商的柔性制造能力、服务响应速度、辅助设计与后端检测服务能力也提出了更高要求。

（2）主营业务分析

2025 年全球经济修复缓慢，宏观环境更加复杂多变。IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织）2025 年 10 月发布的最新研究显示，2025 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2024 年下降 0.1 个百分点。在宏观环境充满不确定性和挑战的背景下，算力基础设施投资进入高景气周期，成为驱动电子信息产业结构性增长的核心动能，带动电子电路产业需求增长。

在市场拓展方面，公司重点把握 AI 算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇，不断强化市场开发力度、提升产品技术竞争力，推动产品结构进一步优化。在运营管理方面，公司深入推进数字化转型与智能制造升级，运营效能提升。在可持续发展领域，公司践行“双碳”战略，进一步完善产品碳足迹管理，完成国际温室气体管理标准体系 ISO14064 认证。报告期内，公司实现营业总收入 236.47 亿元，同比增长 32.05%；归属于上市公司股东的净利润 32.76 亿元，同比增长 74.47%。

1) 印制电路板业务受益于 AI 算力及汽车电子市场发展机遇，收入和利润显著增长

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 143.59 亿元，同比增长 36.84%，占公司营业总收入的 60.73%；毛利率 35.53%，同比增加 3.91 个百分点。

通信领域，根据专业机构 Dell'Oro 最新研究，全球无线网络接入（RAN）市场在经历两年的周期性调整后有所改善，2025 年前三季度整体需求保持平稳；有线侧受通信服务及云服务提供商的投入增加，高速交换机、光模块需求显著增长。报告期内，公司积极把握行业需求释放带来的增长机遇，凭借行业领先的技术水平与高效优质的服务能力，推动产品结构持续优化，订单规模大幅增长。

数据中心领域，2025 年全球云服务厂商资本开支规模持续增加，驱动 AI 服务器及相关配套产品需求快速增长。报告期内，公司受益于 AI 算力基建浪潮，AI 服务器及相关配套产品需求加速释放，订单同比显著增加，成为 PCB 业务增长的关键动力。

汽车领域，根据专业研究机构 Marklines 数据显示，2025 年全球新能源汽车销量合计约 1,812.4 万辆，同比增长 18%。报告期内，公司把握 ADAS 和新能源汽车三电系统增长机会，汽车领域订单保持快速增长。

报告期内，PCB 业务面临阶段性的产出压力，公司通过技术改造打通产能瓶颈、数字化与精益管理提升产出效率，产能有效释放，为业绩增长提供了有力支撑。同时，公司通过内部技术攻坚，进一步强化算力相关产品的竞争力，为关键项目的争取奠定了坚实基础。新项目方面，泰国工厂以及南通四期项目均于 2025 年下半年顺利实现连线投产。

2) 封装基板业务深耕能力建设、抢抓市场机遇，收入和利润双提升

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 41.48 亿元，同比增长 30.80%，占公司营业总收入的 17.54%；毛利率 22.58%，同比增加 4.43 个百分点。

根据 WSTS（世界半导体贸易统计协会）统计数据显示，2025 年全球半导体销售额同比增长 26.2%，其增长主要来自与 AI 算力相关的逻辑类和存储类芯片。报告期内，公司封装基板业务技术能力快速突破，产品与客户导入进程加速，推动订单同比快速增长。

BT 类封装基板方面，公司存储类产品制造能力持续突破，推动客户高端 DRAM 产品项目的导入及量产，带动公司相关产品订单显著增长；处理器芯片类产品，FC-CSP 类工艺能力稳步提升，市场竞争力持续增强；RF 射频类产品，新客户新产品陆续导入，目标产品完成量产。FC-BGA 类封装基板方面，产品线能力稳步提升，目前 22 层及以下产品已实现量产，24 层及以上产品的技术研发及打样工作按期推进。

3) 电子装联业务聚焦产品结构优化与运营能力提升，订单收入稳步增长

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 30.75 亿元，同比增长 8.93%，占公司营业总收入的 13.00%；毛利率 15.00%，同比增加 0.60 个百分点。

2025 年，公司电子装联业务把握数据中心及汽车电子领域需求的增长机会，深化客户战略协同，积极推进客户关键

项目，强化专业产品线竞争力建设，带动相关业务营收稳步增长。

内部运营上，依托智能制造与数字化赋能制造过程管理，提升人员效率、保障产品质量，推动运营效益持续优化。同时，加强供应链选型与管理，推进前端辅助设计、后端测试服务等增值业务能力建设，全面提升对客户一站式服务水平。

4) 继续加大研发投入，高阶产品技术能力稳步提升

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模，不断提升研发和创新能力。报告期内，公司研发投入 15.91 亿元，占营收比重为 6.73%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和存储基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。报告期内，公司荣获 2025 年 IPC “Peter Sarmanian 企业荣誉奖”，以及全国印制电路标准化技术委员会授予的“2025 年度标准化工作先进单位”称号，子公司无锡深南、南通深南获评 2025 年江苏省先进级智能工厂。此外，公司新增授权专利 137 项，新申请 PCT 专利 14 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

5) 深入推进数字化转型与流程变革，提升经营管理能力

2025 年，公司持续深化数字化转型，引入与推广人工智能工具，结合多场景赋能业务运营和管理提升；进一步完善制程、运营、流程、设备、产品等维度的数字化建设；推进数字化系统国际化适配升级，为国际化运营发展提供有效支撑。此外，公司通过 IPD(集成产品开发)、ISC(集成供应链)、质量管理等领域核心关键流程优化迭代，持续推进流程化组织建设，为公司业务拓展与高效运营提供有力保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	30,582,928,717.03	25,302,247,864.46	20.87%	22,606,867,760.88
归属于上市公司股东的净资产	17,149,430,529.85	14,617,020,314.27	17.33%	13,183,740,540.64
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	23,646,977,088.98	17,907,445,251.30	32.05%	13,526,425,962.45
归属于上市公司股东的净利润	3,275,738,151.27	1,877,565,481.01	74.47%	1,398,114,737.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,113,627,500.81	1,739,872,642.10	78.96%	997,953,922.58
经营活动产生的现金流量净额	3,838,343,369.18	2,982,221,520.41	28.71%	2,589,283,004.69
基本每股收益（元/股）	4.91	3.66	34.15%	2.73
稀释每股收益（元/股）	4.91	3.66	34.15%	2.73
加权平均净资产收益率	20.79%	13.58%	7.21%	11.07%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,782,896,546.25	5,670,558,187.24	6,300,560,583.88	6,892,961,771.61
归属于上市公司股东的净利润	491,448,182.06	868,569,593.43	965,807,776.13	949,912,599.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,299,573.37	780,177,074.08	916,486,659.97	931,664,193.39
经营活动产生的现金流量净额	612,758,707.92	882,767,635.99	818,629,443.51	1,524,187,581.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,456	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深天科技控股（深圳）有限公司	国有法人	63.97%	426,489,271.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.82%	25,469,627.00	0.00	不适用	0	
平安银行股份有限公司－永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.87%	5,809,090.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资	其他	0.67%	4,447,657.00	0.00	不适用	0	

基金						
富国基金管理有限公司—社保基金 2101 组合	其他	0.57%	3,814,189.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.47%	3,162,391.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司—中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	0.41%	2,735,643.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,396,145.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.35%	2,362,810.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司—摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.31%	2,077,411.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

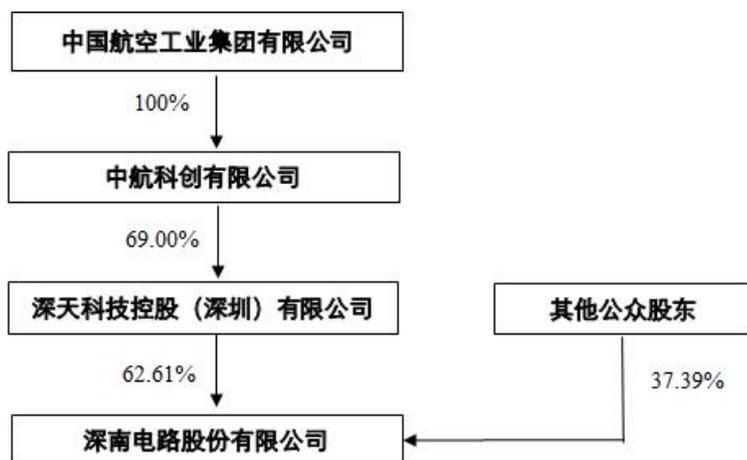
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：截至本报告披露日，深天科技控股持有公司的股份比例为 62.61%。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用。